

魅力と期待の集まる新本部整備

— 新本部における事業／新規産業育成事業(1)についてのご紹介 —

4月号から全12回のシリーズで始まった、「魅力と期待の集まる新本部整備」として、平成23年度開設予定の新本部整備進捗状況や新規産業育成（EMC・半導体、メカトロニクス分野）事業について紹介します。

新本部の工事進捗状況

建築工事は、内装仕上げ、各設備等が施工中、外装工事はほぼ完了します。図1は、屋上階の植樹中、5階光庭にある赤色庇^{ひし}がご覧頂けます。屋上階は、設備機器の据付けを残して完了します。図2は、1階と5階のEMC・半導体分野、3階のメカトロニクス分野の室仕上げが進行中です。

11月末で建築工程は97%が完成します。



図1 新本部建設現場全景
(H22.11.19撮影)



図2 EMC・半導体、メカトロニクス分野の室工事状況
左) EMC、中央) 半導体、右) メカトロニクス
(H22.11.17撮影)

新規産業育成事業

ものづくりのグローバル化が進展する中で、都内中小企業が競争力をつけ、勝ち抜くためには、世界に通用する高付加価値の獲得が求められています。都産技研では、こうした中小企業への支援として、今後産業創出を生む4つの技術分野（環境・省エネルギー、EMC・半導体、メカトロニクス、バイオ応用）に対し、重点的な技術支援を行ないます。

EMC・半導体分野

- 輸出製品の国際規格適合試験を行ないます。
- マイクロ波やミリ波を応用した高周波デバイス設計・開発支援を行ないます。
- 半導体回路設計からアナログ・デジタル混載のHICやMEMSセンサの試作・評価の高付加価値ものづくり支援を致します。
- 図3は半導体分野に導入する電子線描画装置を示します。



図3 電子線描画装置

メカトロニクス分野

- 中小企業が製造する機械へのメカトロニクス技術の応用による高速、高精度、インテリジェント化を支援します。
- ミドルウェア、モジュール部品の活用による先端メカトロニクス・ロボット技術導入の製品開発を支援します。

新拠点新本部に関してご質問のある方は、下記にご連絡下さい。

経営企画部 新拠点準備室 <西が丘本部>
山本 克美 TEL 03-3909-2176
E-mail:yamamoto.katsumi@iri-tokyo.jp

平成23年度 臨海副都心青海に新本部開設